



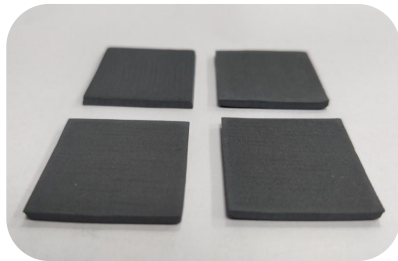
# 鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

## HFS-15

### 【高效能导热垫片】规格书



-产品图-

#### 应用特点：

- 高热导率和低热阻
- 低应力装配
- 良好的热稳定性
- 多种厚度选择，应用范围广

#### 应用领域推荐：

- 卫星，雷达等军事领域
- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 可穿戴设备

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

#### 储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

#### 保质期：

在储存条件下：2年

不符合储存条件下：6个月

鸿富诚 HFS-15 是一款具有良好导热性能，低热阻的高效能导热垫片，可以有效填充发热端与冷却端的空气间隙，实现发热部件到散热部件之间的高效热传递，大幅度降低界面热阻。与此同时，该高效能散热片还可以在较低的应力条件下使用，避免安装应力对芯片、PCB等零部件的损坏。产品极具工艺性和使用性，可以用于光电模块，网通等需要高效热传递的设备。

#### 产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	黑灰色	---	目视
标准尺寸	120*120	mm	ASTM D 5947
厚度	0.5~3	mm	ASTM D374
硬度	65( $\pm 10$ )	Shore 00	ASTM D 2240
密度	3.0( $\pm 0.2$ )	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	$\geq 0.1$	Mpa	ASTM D 412
延伸率	$\geq 100$	%	ASTM D 412
撕裂强度	$\geq 0.5$	N/mm	ASTM D 624
压缩比	$\geq 40$ (@50Psi)	%	ASTM D 695
使用温度	-50~130	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

#### 热学特性

导热系数	24.0( $\pm 5$ )	W/m $\cdot$ K	ASTM D 5470
热阻	$\leq 0.15$ (@20Psi/2mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

#### 不同压缩量对应的瞬间应力

